

公司代码：688591

公司简称：泰凌微

**泰凌微电子（上海）股份有限公司**  
**2025年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.66元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本240,743,536股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数4,242,687股后的股本236,500,849股为基数，以此计算合计拟派发现金红利62,909,225.83元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的49.43%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份4,242,687股，不参与本次利润分配。

2、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司可参与本次分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### 母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

### 8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

#### 1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	泰凌微	688591	不适用

#### 1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	李鹏
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号电梯楼层10层、11层（实际楼层9层、10层）
电话	021-50653177
传真	021-50653177
电子信箱	investors_relation@telink-semi.com

### 2、报告期公司主要业务简介

#### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、公司业务体系

##### （1）公司战略定位与业务演进

自成立以来，公司主要聚焦低功耗无线物联网芯片领域，在蓝牙、Zigbee、Thread、Matter等技术方向持续积累，形成了全球领先的低功耗多协议无线物联网能力，并在智能家居、人机交互、智能零售等多个细分市场建立了广泛的客户基础和领先的市场地位。

在人工智能技术快速向终端侧演进的背景下，物联网设备正由传统“连接节点”向“具备感知、计算与交互能力的智能节点”转变。终端设备不仅需要稳定可靠的无线连接能力，同时也需要在本地完成低功耗、高效率的数据处理与智能决策。

在此趋势下，公司正在从“低功耗无线物联网芯片供应商”，向“端侧 AI 智能节点核心芯片平台”升级，逐步构建“连接+计算+软件平台”的一体化能力体系：

- 在连接层面，公司持续强化多协议融合能力（蓝牙、Zigbee、Thread、Matter、WiFi、星

闪等），满足复杂多样的终端连接需求

- 在计算层面，公司推进端侧 AI 能力集成，实现语音处理、传感器数据分析等本地智能处理能力

- 在软件层面，公司提供从底层协议栈、边缘 AI 算法到应用参考设计的全栈解决方案，提升客户开发效率并增强生态粘性

通过上述能力的持续融合，公司产品正从“连接芯片”升级为“智能节点核心控制与通信平台”，在端侧 AI 时代具备更广阔的应用空间和更高的价值承载能力。

## （2）公司增长驱动结构

为更清晰地呈现公司未来发展的动力来源，公司当前业务及未来增长可分为三个层次：

### ①基石层：稳定规模与现金流基础

公司在低功耗无线物联网领域具备深厚积累，蓝牙、Zigbee、Thread 及 Matter 等产品在全球范围内实现规模化出货，并在智能家居、人机交互、智能零售等领域建立了稳固的领先市场地位。

该类业务具备以下特点：

- 市场需求稳定，应用场景广泛
- 出货规模大，是公司收入与现金流的重要基础
- 客户覆盖全球主流品牌厂商，具备较强的持续性

基石层业务为公司持续投入新技术与新产品提供了坚实基础。

### ②引擎层：驱动增长与结构升级

随着端侧 AI 应用逐步落地，公司在无线音频、边缘 AI 芯片等领域实现快速突破：

- 在无线音频领域，公司产品已进入专业音频设备、会议系统及消费类音频市场，并逐步从高端品牌向更广泛的客户层面渗透

- 在端侧 AI 芯片方面，公司 TL721X, TL751X 等系列产品已实现量产，支持智能语音处理、AI 降噪等功能，广泛应用于高端音频应用等场景

该层业务具备以下特征：

- 单芯片价值量（ASP）显著高于传统芯片
- 毛利率水平相对更高
- 与 AI 应用结合紧密，具备较强成长性

引擎层业务是公司未来收入增长与盈利能力提升的核心驱动力。

### ③潜力层：打开长期增长空间

公司在汽车电子、医疗健康及新型人机交互等领域持续布局：

- 汽车领域：数字钥匙、胎压监测等项目推进顺利，预计未来逐步放量
- 医疗领域：与国内领先厂商合作，应用于连续血糖监测等低功耗场景
- 新兴领域：机器人、脑机接口等前沿应用具备长期潜力

该层业务当前规模较小，但具备以下特征：

- 高技术壁垒
- 长生命周期
- 高附加值

潜力层业务将为公司长期发展提供重要的增长空间和弹性。

## 2、公司主要业务情况

公司的主要业务是低功耗无线物联网芯片的研发、设计与销售，主要聚焦于低功耗蓝牙、双模蓝牙、Zigbee、Matter、WiFi 等短距离无线通讯芯片产品，在私有 2.4G 芯片、无线音频芯片也有长期的技术积累和产品布局。近年来，随着人工智能（AI）的高速发展，AI 算力在边缘设备的需求也快速增长，边缘 AI 设备不仅需要具备低功耗无线连接能力，而且对于本地的低功耗 AI 运算也提出新的要求，需要能够在本地高效处理各种外设和传感器收集到的数据，在保障高隐私可靠性的同时，能快速响应数据处理需求。在这一趋势下，公司进一步推进“AI+IOT”的产品战略，将边缘 AI 同低功耗无线物联网连接能力相结合，推出支持边缘 AI 技术的多个系列芯片和软件开发工具，公司业务进一步向边缘 AI 方向深化和拓展。公司正逐步形成“连接+端侧 AI 融合”的平台型能力，在物联网向智能化升级过程中占据独特的战略位置

公司在低功耗无线物联网芯片领域已处于全球第一梯队，其中在蓝牙、Zigbee 及 Thread 等技术方向具备领先的市场份额与技术能力，公司与 Nordic、Silicon Labs 等国际厂商处于同一竞争梯队；公司产品布局也逐步在无线音频与端侧 AI 领域，WiFi 系统级芯片与 AI 生态领域等方面不断完善。与单一技术路径厂商相比，公司具备以下差异化优势：

- 多协议融合能力：覆盖 BLE、Zigbee、Thread、Matter 及 WiFi 等多种通信技术
- 低功耗技术优势：在功耗控制方面具备长期积累
- 连接与 AI 融合能力：实现通信与本地计算能力的一体化设计。

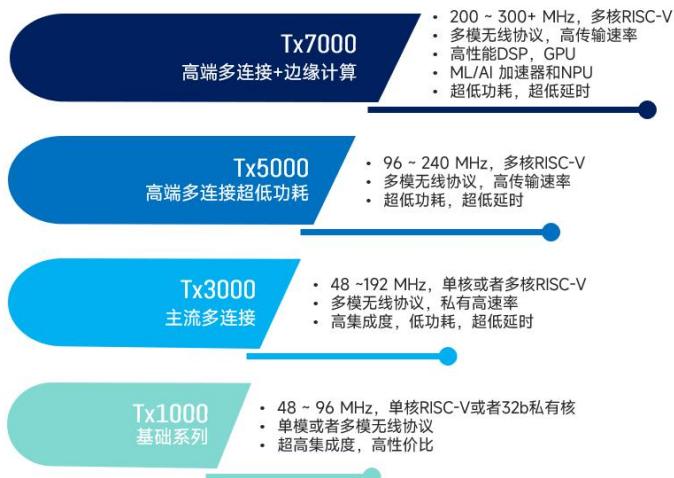
## 3、公司主要产品情况

与公司的战略相匹配，公司的产品矩阵也更加丰富和完整，从传统的 TLSR8，TLSR9 系列，扩展到 Tx1000 ~ Tx7000 等多个系列多个层次的产品组合，完整的覆盖了低功耗无线物联网多模

连接，智能组网，边缘 AI 运算等多样化的需求。

## 丰富多样 产品矩阵

面向未来的无线低功耗多模系统  
级芯片：智能，互联，边缘运算



公司在系统级芯片和硬件运算能力基础上，进一步为下游客户提供全栈式软件解决方案，从最底层的驱动固件，到多协议多模式的标准与私有协议栈，再到面向多样性应用的参考设计，大大减轻了下游客户开发负担，缩短开发时间，加速客户产品落地的节奏，同时也增加了客户的粘性。全栈式软件也形成了公司的核心竞争力之一，为公司快速推出不同协议，多模组合的灵活架构方案奠定了坚实的基础，也使得公司在最新标准和软件功能的支持上总能占据先机。



公司的产品领域极其广泛，客户行业分散多样，包含但不限于智能家居、边缘 AI、低延时无线音频、智能遥控、汽车电子、人机交互、游戏电竞、智能穿戴、医疗健康、智能零售、智能工业、智能照明等领域。



公司的产品被大量国内外一线品牌所采用，包括以谷歌、亚马逊、小米等物联网为代表的生

态系统企业以及其生态链企业，也包括不同垂直市场的头部企业，例如罗技、联想等一线计算机外设品牌，Vizio、创维、长虹、海尔等一线电视品牌，JBL、Sony 等音频产品品牌，涂鸦智能、云鲸等智能家居品牌。和一线品牌客户的长期合作，体现了公司在产品性能上的领先性，以及产品的高品质和服务的高质量。公司基于和长期一线客户的路线图分享，进一步加深产品设计的深度和广度，构成了公司的竞争优势和商业壁垒。

除了一线品牌生态企业和垂直行业头部品牌客户外，公司也积极布局长尾市场，建立了完善的在线文档系统、网络论坛、销售和代理网络，为中小型客户提供易上手、免支持的软硬件参考设计和产品，进一步增加了业务和服务对象的覆盖面。公司对于下游客户提供完善的服务和对接体系，从最初的接触和技术评估，到最终的量产支持和长期扶持，实行全生命周期一站式服务，与众多客户形成了长期的合作关系。

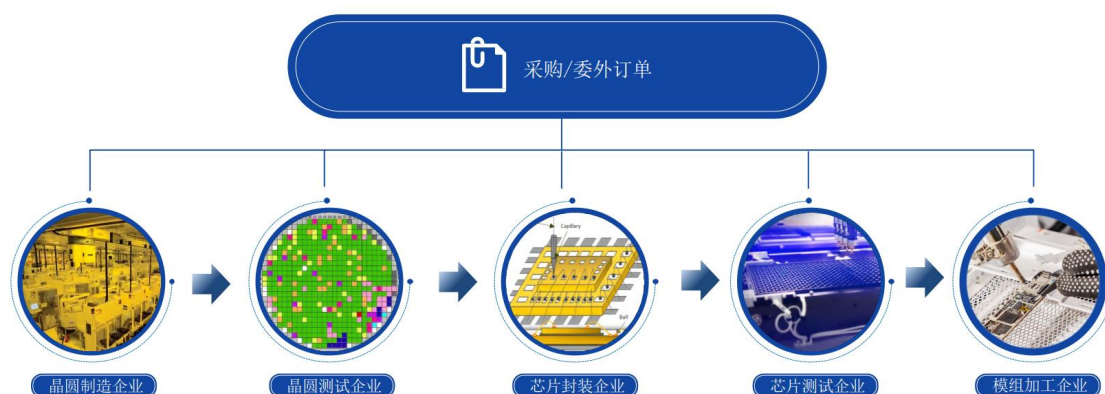
### 全生命周期一站式服务



## 2.2 主要经营模式

公司专注于芯片的设计、研发和销售，采用行业通行的 Fabless 模式即无晶圆厂模式，将芯片制造环节外包给专业的晶圆代工厂商，封装测试环节则外包给专业的封装测试厂商。采用无晶圆厂模式，公司无需投入大量资金建设和维护制造工厂，大大降低了资金门槛和运营风险，能够集中优势资源投入到芯片设计研发中，有利于提高产品的技术含量和竞争力。通过与不同的代工厂商进行合作，公司还能根据自身需求灵活选择最合适的制造伙伴和工艺，提高生产效率，公司与多个海内外供应商维持良好的合作，确保了供应链的灵活性和弹性。

公司的芯片成品主要用于直接对外销售，部分芯片则委托模组厂商加工成模组，再对外销售。



## 2.3 所处行业情况

### (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家专业的集成电路设计企业，主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型信息技术服务”之“集成电路设计”行业。

公司所属行业属于国家重点培育和发展的七大“战略性新兴产业”中的“新一代信息技术产业”，该行业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是支撑国民经济和社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，也是我国进口依存度大、亟需提升国产化水平的产业，因此受到国家多项法规政策的扶持鼓励，对国民经济健康发展具有重要的战略意义。

#### （一）行业发展阶段及基本特点

在过去数年里，以蓝牙、Zigbee、Thread、Matter 和 WiFi 等为代表的短距离无线连接技术彻底改变了人类的生活，已经形成一个庞大并快速成长的互联设备生态系统。这些技术有些已经有 20 多年的历史，经历了重大变革和多次迭代，有些则是方兴未艾，但都显著提高了性能、效率、可靠性、安全性和可扩展性。以其中历史最为久远的蓝牙为例，该技术从上世纪末形成开始，已经从经典的以音频为中心的技术演变为低功耗、多连接形式的物联网(IoT)应用的领先无线技术，应用范围也从简单的无线连接，扩展到智能家居，工业物联，医疗健康，汽车网联等众多领域。

消费者和物联网应用的巨大多样性，使得单一技术无法满足每个市场的需求。这种演变导致短距离无线技术市场格局极其复杂，由于不同的可行技术各有优势，适用于不同消费者和商业场景，因此公司需要适应这些无线技术的发展趋势，推出支持相应技术功能的芯片和协议栈，以满足客户多样性的产品开发需求。

除此之外，随着人工智能和大数据的快速发展，无线物联网芯片行业进一步迎来了新的增长机遇。特别是在物联网和智能边缘 AI 设备领域，对高性能、低功耗芯片的需求不断增加。无线物

联网芯片和边缘 AI 的发展也呈现出以下新特点：一是芯片制造工艺的持续进步，先进的工艺不断涌现，使得芯片性能大幅提升、功耗显著降低；二是全球芯片产业链的重塑，国际贸易摩擦和地缘政治因素导致供应链的多元化增加，推动相关产业的多元化和自主化发展；三是人工智能和机器学习技术的融合，为芯片设计带来了新的挑战和机会，芯片需要具备更强的计算能力和更高的能效比，以满足智能设备对实时数据处理的需求。四是端侧 AI 与无线连接的融合应用加速落地，音频、智能家居、工业等领域成为端侧 AI 芯片的核心落地场景，市场对低功耗、高算力的端侧 AI 芯片需求进入规模化增长阶段；五是以游戏、高端影音等为代表的消费电子领域对超高传输速率、超低延迟的无线连接技术提出更高要求，真 8K 无线传输、多设备音频同步成为技术发展新方向。

## （二）技术门槛

### （1）低功耗

在物联网无线连接设备和边缘设备中，功耗始终是最核心的指标之一，其中射频电流、睡眠电流、处理器效率等是关键挑战。从芯片设计的最初阶段就需要考虑降低功耗，通过优化电路结构以降低射频电流和睡眠电流，在兼顾性能的情况下提高处理器效率，以延长电池寿命。端侧 AI 运算的低功耗优化成为新核心难点，需在保证 AI 算法高效运行的前提下，实现芯片整体功耗的精准控制。

### （2）射频性能和多模无线射频技术

发射功率、接收灵敏度、抗干扰性能是射频性能的关键指标。芯片需要在保持良好射频连接的同时，尽可能降低功耗，以满足物联网设备对长时间待机和稳定连接的需求。随着多种低功耗无线物联网技术的广泛应用，单个射频芯片需要支持多个不同的通信标准和协议，这对于无线收发机的设计也提出了更高要求，需要在有限的资源下满足多种无线通信发射和接收，保持低功耗和高性能。此外，高端消费电子场景对无线速率提出 6Mbps 及更高的要求，射频设计需兼顾高速率传输与低延时、低功耗的多重需求。

### （3）高集成度

物联网设备由于其海量的需求对于系统的成本也较为敏感，同时在很多应用场景中，设备需要具有极小的面积/体积。芯片需要在尽可能小的尺寸内实现高度集成，以便吸收外部器件并增加新功能。这要求芯片设计具备良好的可扩展性和灵活性，能够满足不断变化的物联网应用需求。现阶段集成需求进一步升级，需在单芯片中融合双核处理器、AI 加速模块、混合存储架构及丰富外设接口，同时适配不同设备的多样化封装需求。

#### （4）端到端超低延迟

在物联网应用中众多设备对于系统延时和响应速度具有苛刻的要求，满足毫秒级甚至是亚毫秒级延迟的需求是关键挑战。芯片需要综合考虑从最底层硬件到最上层软件的系统级优化，以实现端到端的超低延迟，从而提供快速响应的用户体验。真 8K 无线游戏、超低延迟音频、机器人控制、智能语音交互系统等场景对延迟的要求进一步严苛，需通过专用技术（如 Telink HDT）实现极致的无线传输低延时。

#### （5）高复杂度的系统架构

随着产品的不断进步，芯片设计需要应对更复杂的系统级设计和架构。例如，多核架构的引入、异构计算的支持、边缘 AI 处理功能的添加以及芯片与软件的协同设计，都成为提升芯片性能和竞争力的重要手段。现阶段架构设计需兼顾 RISC-V 处理器、高性能 DSP 处理器、神经网络处理器（NPU）、图形处理器（GPU）等的高效协同，支持基于 TensorFlow、PyTorch、ONNX 等多种框架 Edge AI 模型的快速转换和部署，实现芯片与 EdgeAI 开发平台的深度协同。

#### （6）安全性和可靠性

安全性和可靠性已成为技术门槛的重要组成部分，特别是在物联网和智能设备中，芯片需要具备更强的抗攻击能力和数据保护机制，以应对日益复杂的安全威胁环境。系统级芯片和协议栈需要确保物联网设备和边缘 AI 计算设备满足高隐私、高可靠、高加密、可认证、可溯源的众多安全要求，从最核心的信任根（Root of Trust）到软件 OTA 的安全保护，需要芯片从硬件和软件多个层面具备安全功能。

#### （7）EdgeAI 技术

随着边缘人工智能（EdgeAI）的兴起，芯片设计需要支持边缘计算和人工智能功能。这要求芯片具备更强的计算能力和更高的能效比，并集成专用的 AI 加速模块，以实现高效的数据处理和机器学习算法的运行。同时，EdgeAI 还对芯片的实时性、低功耗和安全性提出了更高要求，以满足智能家居、智能办公、无线音频等领域的应用需求。现阶段 EdgeAI 技术门槛进一步提升，需实现本地 AI 交互的全流程落地，支持断网状态下的设备智能控制，同时保证 AI 模型移植的高效性，满足开发者快速开发的需求；此外，EdgeAI 与 Matter、蓝牙等协议的融合设计，成为跨场景应用的核心技术要求。

## （2）公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在所处行业的多个领域拥有突出优势，地位稳固。公司的蓝牙低功耗系统级芯片长期位于市场的头部位置，成为全球第一梯队的代表之一。在 Zigbee 领域，公司是出货量最大的本土

Zigbee 芯片供应商，并稳居全球前列，在本地和国际市场上有强劲竞争实力。公司的 Thread 和 Matter 芯片紧跟最新的协议标准，在国际头部芯片供应商中占据一席之地。公司还在 2.4G 私有协议芯片领域取得领先地位，特别是在以无线和 AI 人机交互设备（HID）、智能零售电子货架标签（ESL）为代表的主要应用市场。在无线音频芯片方面，公司支持多种无线音频技术，包括最新的蓝牙低功耗音频技术，公司芯片已广泛应用于国际头部品牌的产品线。

在垂直应用市场中，公司建立了稳固的市场地位。在智能遥控器市场，公司芯片凭借多年的技术积累和市场验证占据了全球相当重要的份额；在智能零售电子货架标签（ESL）市场，公司提供高性价比的芯片和灵活的技术方案，出货量逐年增长，处于国内龙头地位；公司在细分无线音频产品领域具备独特的市场优势，特别是在超低延迟和多模共存音频设备方面。这些领域优势的叠加使得公司在无线低功耗物联网和边缘 AI 领域具备广泛的市场影响力和竞争实力。

近年来，随着芯片行业的快速发展和市场竞争的加剧，公司在技术创新和市场拓展方面取得了显著进展。一方面，公司积极布局新一代无线通信技术的研发，例如 WiFi-6 多模芯片、星闪（NearLink）多模芯片，进一步巩固了在物联网芯片领域的领先地位，2025 年，公司完成支持星闪技术的多模低功耗物联网芯片流片。另一方面，公司紧跟 EdgeAI 技术的发展趋势，推出了多款支持边缘计算和人工智能的芯片产品如 TL721X、TL751X 系列等，这些产品凭借高性能、低功耗和强大的端侧数据处理能力，已在智能家居、智能办公和无线音频等领域得到广泛应用。2025 年下半年，公司密集发布并落地多款芯片与模组产品：推出 TC321X、TL321X 两款全新低功耗物联网芯片，丰富产品矩阵，其中 TL321 SoC 主打高性价比，成为 Matter over Thread 领域的核心入门级产品，精准适配中小厂商智能家居设备的开发需求；同步发布 ML7218X（含 ML7218A、ML7218D）、ML3219D 高性能物联网模组，并于 2025 年 8 月 IOTE2025 深圳物联网展首次亮相，ML7218X 模组更斩获该展会“通信与定位产品”类别创新金奖，此外公司还推出 Wi-Fi 6 核心模组 ML9118A，构建起多品类、全场景的模组产品布局。

同期，公司端侧 AI 芯片迎来放量出货，核心的 TL721X 系列芯片已实现量产，广泛应用于智能耳机、会议麦克风等音频领域，2026 年该类芯片出货规模将跻身行业前列，且在智能家居、工业、健康、室内定位等领域的项目落地正持续推进。2026 年 1 月，公司于 CES（全球消费电子展）展出即将发布的突破性新品 TL322X SoC，该芯片搭载双核处理器、集成 Telink HDT 技术，支持 6Mbps 无线速率，助力游戏外设迈入真 8K 无线时代，公司借此有望成为全球无线游戏解决方案的核心供应商之一。

随着蓝牙技术联盟中国实体于 2025 年 3 月中旬正式成立，联盟中的中国成员公司迎来了前所

未有的发展机遇。公司作为行业先锋，一直深度参与蓝牙技术的演进，目前除在董事会扮演重要角色外，也积极参与联盟战略委员会、系统架构委员会和各重要工作组。公司技术团队也在多个标准发布前的互操作测试阶段中贡献了众多的成功测试用例。公司是全球少数最早提供量产级蓝牙 Mesh 组网解决方案的芯片设计公司，也是首批支持蓝牙低功耗音频、蓝牙角度定位和基于蓝牙的电子价签等芯片和协议栈功能的企业之一。公司的超低功耗蓝牙 TL721X 系列芯片、TLSR922X 系列芯片和自研协议栈成功成为全球非手机芯片公司中首个获得蓝牙 6.0 认证的产品系列。公司的芯片布局也将持续紧密匹配蓝牙最新标准路线图，为下游客户提供丰富的选择。2025 年上半年，蓝牙联盟发布 6.1 标准，公司第一时间完成 6.1 产品认证。2025 年下半年，蓝牙技术联盟持续推出蓝牙超低延时（ULL）领域核心新标准，8 月发布 HID over ISO 标准、11 月发布作为蓝牙核心规范 6.2 核心特性的 SCI（Shorter Connection Intervals）标准，大幅突破无线连接的延时与报点率上限。公司深度参与两项 ULL 新标准的制定与落地，全程参与联盟工作组相关工作并贡献专业技术意见，提前布局原型机开发并参与全球 IOP 测试，其中在 HID over ISO 领域贡献超 50% 的 IOP 测试结果，斩获蓝牙技术联盟 HIDWG 2025 年度“Outstanding IOP Contributor”奖章；在 SCI 标准制定中，多项技术意见被正式采纳，同时通过 IOP 测试获得蓝牙技术联盟“Recognition of IOP participation”认可，成为两项新标准的核心贡献企业。公司始终紧密匹配蓝牙技术联盟最新标准路线图，以技术前瞻布局持续夯实行业领先地位，为下游客户提供贴合市场需求的蓝牙芯片解决方案。

公司持续保持与国内外知名企业的合作，共同推动行业标准的制定和技术的普及，提升了其在全球芯片产业链中的影响力。通过技术创新与合作并举，公司持续巩固其在行业内的领先地位。

### (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025 年下半年蓝牙技术联盟接连推出 HID over ISO、SCI 两项 ULL 超低延时新标准，大幅提升无线连接的响应速度与报点率，公司深度参与这两项标准的制定与落地，凭借技术贡献斩获联盟多项认可。

针对 Matter 1.5 新标准，公司已完成核心协议栈升级，各型号芯片正按计划逐步实现新功能适配，并推出全系列 Matter 芯片方案：Matter over Thread 领域，高端款 TL721X 搭载主频 240MHz RISC-V MCU，简化版 TL321X 主打高性价比，TL323X 专为低功耗电池供电传感器节点打造并提供最高 4MB flash 内存；Matter over Wi-Fi 领域，TLSR9118 支持 Wi-Fi 6 且无需边界路由器即可稳定连接，适配固件快速升级等高速传输场景；同时公司打造 Matter+EdgeAI 融合方案，基于 TL-EdgeAI 开发平台实现本地 AI 交互，解决云端延迟与隐私风险，且支持多模型快速移植，

大幅提升开发者效率。

公司星闪多模芯片研发持续推进，后续将结合星闪 2.0 标准的商业化落地节奏，实现芯片的量产和市场推广，重点布局遥控器、键盘、鼠标等智能终端星闪技术核心应用场景。

公司端侧 AI 芯片进入放量出货阶段，核心应用于音频领域的 TL721X 系列芯片已实现规模化量产，其 EdgeAI 智能降噪方案成为行业标杆；2026 年公司端侧 AI 芯片出货规模将实现大幅增长，智能家居、工业、健康、室内定位等领域的项目将逐步落地，成为公司新的业绩增长极；同时公司 TL-EdgeAI 开发平台支持 LiteRT、TVM 等多种 AI 模型，可转换 TensorFlow、PyTorch、JAX 等主流框架训练的模型，实现 AI 模型的快速移植，大幅降低开发者的应用门槛。

公司将 RISC-V 架构与 EdgeAI、Matter 1.5、蓝牙 6.2 等新技术深度融合，TL721X 搭载主频 240MHz 的 RISC-V 32 位 MCU，并支持 DSP 扩展指令集，成为 RISC-V 架构在 Edge AI 领域的核心应用产品；2025 年下半年发布的 TL321 SoC 及 ML7218X、ML3219D 模组均基于 RISC-V 架构打造，其中 ML7218X 搭载 240MHz 32 位 RISC-V 微控制器，ML3219D 搭载 96MHz 32 位 RISC-V 微控制器，均支持 DSP 扩展指令，进一步夯实了公司在 RISC-V 开源芯片领域的技术优势；后续公司将持续基于 RISC-V 架构推出更多高算力、低功耗的芯片产品，覆盖游戏、智能汽车、工业物联网等应用领域，进一步强化在 RISC-V 开源芯片领域的领先地位。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	2,613,925,843.91	2,489,383,481.77	5.00	2,429,901,789.73
归属于上市公司股东的净资产	2,434,665,000.95	2,342,996,034.64	3.91	2,341,382,866.11
营业收入	1,015,027,035.49	844,033,021.15	20.26	636,091,867.00
利润总额	125,449,816.76	92,291,163.85	35.93	50,206,546.65
归属于上市公司股东的净利润	127,280,477.41	97,410,270.82	30.66	49,771,753.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,327,304.06	90,833,367.52	28.07	22,905,990.11
经营活动产生的现金流量净额	191,333,875.42	149,719,504.96	27.79	150,949,854.64
加权平均净资产收益率(%)	5.34	4.16	增加1.18个百分点	3.53
基本每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71	0.25

稀释每股收益（元/股）	0.53	0.41	29.27	0.25
研发投入占营业收入的比例（%）	27.17	26.06	增加1.11个百分点	27.16

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	230,046,348.02	273,443,402.53	262,869,989.32	248,667,295.62
归属于上市公司股东的净利润	35,712,341.35	65,364,082.75	38,614,635.78	-12,410,582.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,084,133.85	58,964,255.53	36,308,237.43	-13,029,322.75
经营活动产生的现金流量净额	14,302,546.59	72,814,368.40	92,241,355.95	11,975,604.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4、 股东情况

### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							23,374
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							22,243
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京华胜天成科技 股份有限公司	0	17,861,940	7.42	17,861,940	无		境内非 国有法 人
国家集成电路产业 投资基金股份有限 公司	-5,726,717	15,761,683	6.55		无		国有法 人
上海芯狄克信息科 技合伙企业(有限合	0	14,530,320	6.04	14,530,320	无		境内非 国有法

伙)							人
上海芯析企业管理合伙企业（有限合伙）	0	12,885,300	5.35	12,885,300	无		境内非国有法人
盛文军	25,000	7,571,320	3.14	7,546,320	无		境内自然人
上海凌析微管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	5,526,000	2.30	5,526,000	无		境内非国有法人
王维航	6,250	5,026,090	2.09	5,019,840	无		境内自然人
ZHENG MINGJIAN	25,000	4,740,820	1.97	4,715,820	无		境内自然人
上海浦东新兴产业投资有限公司	-2,077,090	4,198,610	1.74	0	无		国有法人
深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）—深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	4,143,141	1.72	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京华胜天成科技股份有限公司、盛文军、上海凌析微管理咨询合伙企业（有限合伙）、ZHENG MINGJIAN 以及未在前十大股东中列示的北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）、金海鹏为公司实际控制人王维航的一致行动人；上海芯狄克信息科技有限公司（有限合伙）、上海芯析企业管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人王维航控制的企业。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

#### 存托凭证持有人情况

适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

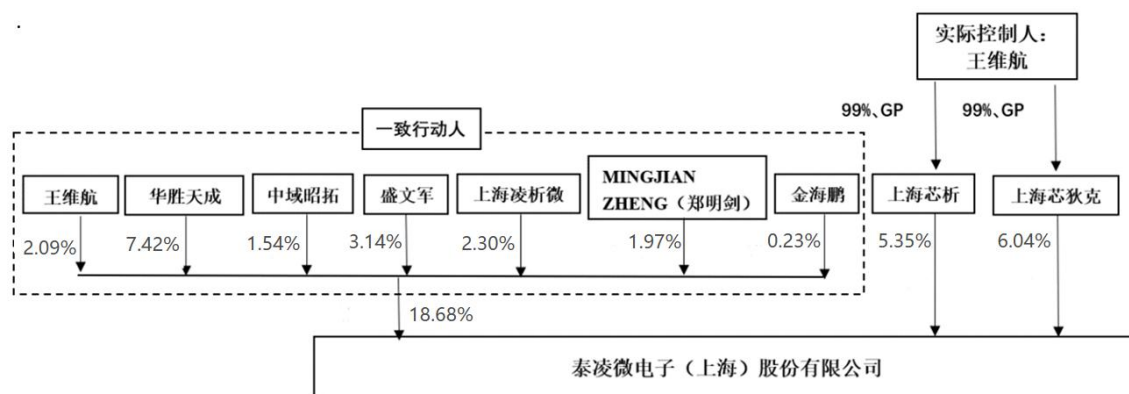
适用 不适用

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5、公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 10.15 亿元，同比增长 20.26%；归属于上市公司股东的净利润 1.27 亿元，同比增长 30.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.16 亿元，同比增长 28.07%；归属于上市公司股东的扣除股份支付影响后的净利润 1.69 亿元，同比增长 53.68%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用